



电子级玻璃纤维

人工智能基础设施的扩张，拉动印刷电路板的需求，进而推动生产电子级玻纤所需的铂金需求上升

低损耗材料

在电子级玻璃纤维的制造过程中，可以通过调整玻璃成分、厚度规格和织造技术来生产具有不同特性的材料。用于印刷电路板的电子级玻璃纤维布已开发出低介电常数/低损耗（Low-DK）特性，以满足新技术的要求。除去其他优点外，低介电常数材料还能提供快速的信号传输并减少信号损耗。

人工智能服务器和数据中心设备的运行都离不开印刷电路板。随着人工智能算力工作量的持续增加，印刷电路板的设计也在不断迭代，用以支持更高的速度和频率，尤其是通过集成低介电常数材料来实现。

预计2026年玻璃行业的铂金需求将同比增长83%，至11.7吨。由于去年玻璃纤维行业净新增产能扩张出现周期性停滞，需求基数较低，仅为6.4吨，而今年将从2025年的低基数上实现复苏。需求的增长受到玻纤应用领域新一轮扩张的驱动，这得益于产能建设的恢复，以及包括人工智能在内的高附加值终端应用的需求增强。

铂金其中一个独特属性在于，它是一种极其耐热、耐磨的金属元素。在玻璃纤维生产中，采用铂铑合金漏板，在极高温下将熔融玻璃拉制成细丝。通过这种方式生产的玻璃纤维，可用于制造电子级玻璃纤维（E-glass）纱，进而织造成不同类型的电子级玻璃纤维布。

电子级玻璃纤维布以其高强度和优异的电绝缘性能著称，是印刷电路板（PCB）的重要组成部分。印刷电路板是一种电子组件，通过铜导体在各元器件之间建立电子连接，使先进半导体能够以极高的数据速率相互通信。在印刷电路板中，电子级玻璃纤维布浸渍环氧树脂后层压形成基板，即印刷电路板的结构基础。其作用是提供机械稳定性，同时确保电路板能够承受热应力和电应力。



玻璃纤维。图片来源：sandris - stock.adobe.com

此外，电子级玻璃纤维是聚合物基复合材料（PMCs）中使用最广泛的增强纤维。聚合物基复合材料是一种高性能工程材料，由聚合物树脂基体将增强纤维（如碳纤维、玻璃纤维或芳纶纤维）粘结而成。杜邦公司开发的凯夫拉

（Kevlar®）就是由芳纶纤维制成的织物实例。聚合物基复合材料因其卓越的比强度、设计灵活性和耐腐蚀性，被广泛应用于航空航天、汽车和体育用品行业。

联系方式:

Vicki Barker, 投资者沟通部, vbarker@platinuminvestment.com

Brendan Clifford, 机构销售部, bclifford@platinuminvestment.com

Edward Sterck, 研究部, esterck@platinuminvestment.com



免责声明: ©2026 世界铂金投资协会有限公司保留所有权利。世界铂金投资协会名称和标志以及WPIC是世界铂金投资协会有限公司的注册商标。未经授权，不得以任何方式复制或分发本报告的任何部分。世界铂金投资协会未经任何监管机构授权提供投资建议。本文件中的任何内容均无意或不应被解释为投资建议、出售或建议购买任何证券或金融工具，在进行任何投资之前，应始终寻求适当的专业建议。图片仅用于说明目的。更多详细信息请访问WPIC官网：<http://www.platinuminvestment.com>。